

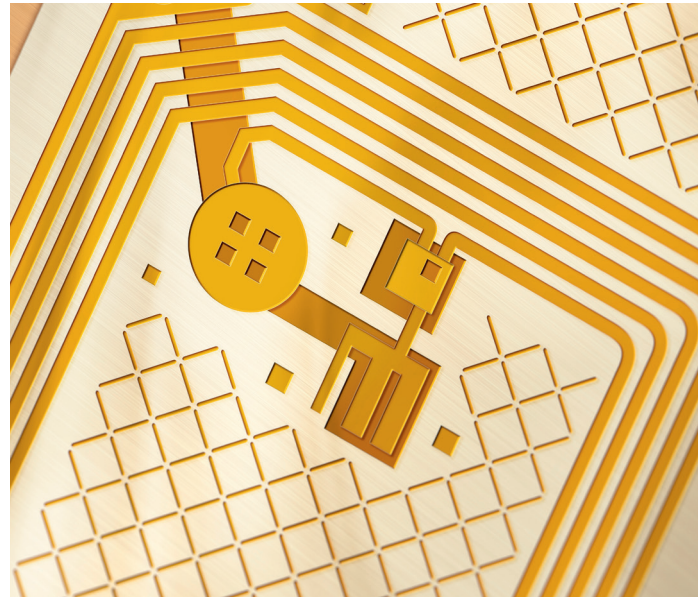
MicroCat

铜导体 - 印刷和电镀

印刷导体 固体铜 两者的最佳选择

MacDermid Enthone的MicroCat是唯一采用成熟技术将印刷和电镀工艺相结合,能够以极低的成本满足大批量先进电路的需求。MicroCat是加层电路技术的进化,消除了RFID加速渗透的主要障碍。它提供了卓越的性能,并如您所愿由MacDermid Enthone的全球资源提供支持。

MicroCat旨在通过减少从印刷到电镀的工艺步骤来提高生产率。制造成本分析显示,由于在这个简化的工艺流程中使用铜而不是银,节省了大量材料和人工。MicroCat制程的化学沉铜导电性和电镀均匀性也为RFID制造商提供了比印刷的导电油墨更大的“读取距离”。



主要特性优点

- 简单, 三步流程
- 独特的催化剂油墨与任何柔性基材兼容
- 加层铜沉积具有世界上最好的导电性和均匀性
- 适合所有印刷技术
- 得到验证的生产经验, 有保障的全球支持
- 以最低的拥有成本实现高产量生产力



MacDermid Enthone

CIRCUITRY SOLUTIONS

MicroCat

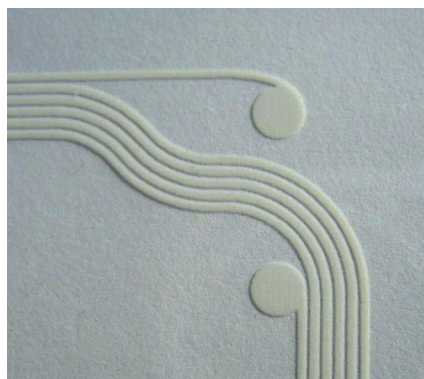
铜导体 - 印刷和电镀

加层电路技术的发展

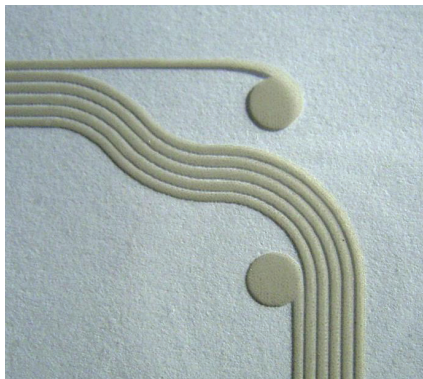
MacDermid Enthone MicroCat是低成本、高生产率、高性能的溶液，专为低价电路的制造商而设计。使用MicroCat目前可以实现为任何应用开发先进电路的能力。

MicroCat的灵活性不仅限于印刷基板，它为许多应用和行业提供了大量解决方案，包括银行卡、能源、库存跟踪、安全和可穿戴电子产品。MicroCat采用独特的催化剂，可使用任何印刷技术进行转移，将传统的印刷和电镀工艺简化为三个步骤的同时提供了卓越的电气性能。如果降低总体成本的同时提高生产力对您来说很重要，请立即联系我们。

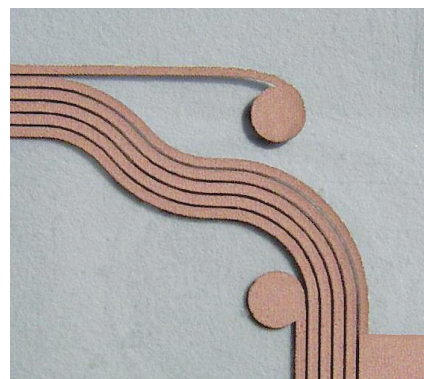
印刷催化剂油墨后



还原后

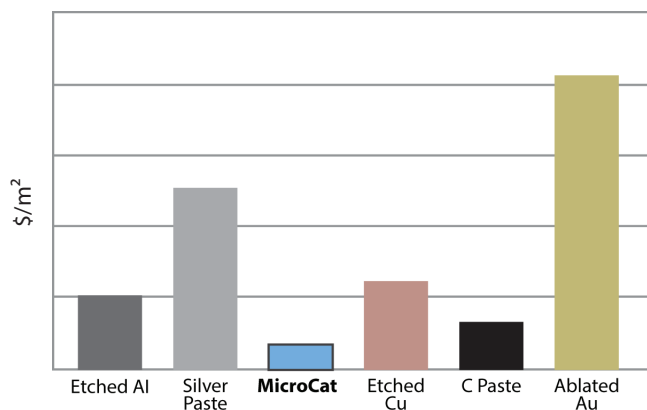


镀铜后

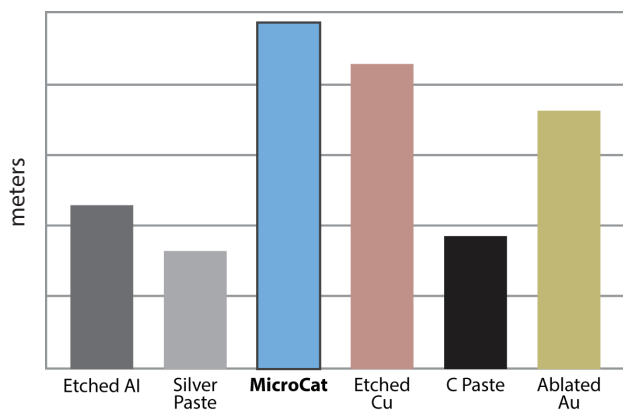


量化价值

Cost



Read Distance (13.5mhz tag)



macdermidalpha.com
October, 2019

MacDermid Enthone is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.

© 2019 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved.

® and ™ are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.